

무상 기증 시 세액공제를 적용받는 시설·장비(제7조의2제13항 관련)

구분	시설·장비
1. 전공정 시설·장비	가. 웨이퍼 제작 공정에 사용되는 시설·장비 나. 산화 공정에 사용되는 시설·장비 다. 포토 공정에 사용되는 시설·장비 라. 식각 공정에 사용되는 시설·장비 마. 이온주입 공정에 사용되는 시설·장비 바. 증착 공정에 사용되는 시설·장비 사. 화학기계적 연마 공정에 사용되는 시설·장비 아. 금속배선, 패키징과 테스트 공정에 사용되는 시설·장비 자. 계측 공정에 사용되는 시설·장비 차. 웨이퍼 표면의 불순물을 제거하는 공정에 사용되는 시설·장비
2. 후공정 시설·장비	가. 후면연삭(Back Grinding) 공정에 사용되는 시설·장비 나. 절단(Wafer Dicing) 및 접착(Attach) 공정에 사용되는 시설·장비 다. 와이어본딩(Wire Bonding) 공정에 사용되는 시설·장비 라. 몰딩(Molding) 공정에 사용되는 시설·장비 마. 패키징 및 테스트 공정에 사용되는 시설·장비 바. 계측 공정에 사용되는 시설·장비